

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-025

江西红板科技股份有限公司 关于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产 能扩充项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目
- 实施主体：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 项目总投资：预计总投资不超过人民币 70,000 万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于购买机械钻机、激光钻机、成型机等生产设备及配套设施改造，扩充部分车间产能，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
- 审议情况：本次投资事项经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司股东会审议
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
 - 本项目尚需完成项目备案、环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。
 - 项目建设周期内，设备采购价格等存在波动风险，可能造成项目投资成本超预期；同时设备交付周期、安装调试进度、技术人员配置等因素可能导致产能释放延期。下游电子行业技术迭代、市场需求变化也将影响新增产能的利用效率与经济效益。
 - 项目资金投入规模较大、建设周期较长，阶段性资金支出将抬升公司短期资产负债率，增加阶段性财务压力；若融资环境发生变化、后续产能规划落地不及预期，还可能面临融资成本上升、厂房利用率不足等风险。

公司将密切跟踪各项审批、设备采购及行业动态，强化项目进度管理、资金统筹及市场拓展规划，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各

位投资者理性投资，注意投资风险。

一、 对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为抢抓高端电子产业发展机遇，完善高精密 HDI 电路板产能布局，匹配公司高阶精密电路板中长期扩产规划，公司拟在现有厂区内实施高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目，通过购置机械钻机、激光钻机、成型机等先进生产设备，对部分车间进行技术改造，扩充高精密 HDI 电路板产能。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） --增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☒其他： <u>技术改造与产能扩充项目</u>
投资标的名称	高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：不超过 70,000 ☐ 尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 ☒其他： 自筹资金 ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他： _____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案》，同意公司使用不超过 70,000 万元的自有资金及自筹资金投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资项目基本情况

（一）投资标的概况

投资类型	☒ 其他：技术改造与产能扩充项目
项目名称	高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目
项目主要内容	本项目在公司现有厂区内对部分车间进行技术改造，购置机械钻机、激光钻机、成型机等先进生产设备及配套设施，扩充高精密 HDI 电路板产能，提升公司高阶精密电路板生产能力与技术水平。
建设地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区公司现有厂区内，利用现有厂房进行技术改造，不新增对外征地
项目总投资金额（万元）	本项目预计总投资不超过人民币 70,000 万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于购买机械钻机、激光钻机、成型机等生产设备及配套设施改造，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
上市公司投资金额（万元）	不超过 70,000 万元（最终以项目建设实际实施金额为准）
项目建设期	24 个月，分阶段完成厂房装修、设备采购及安装调试、试生产及产能爬坡等工作
预计开工时间	2027 年 1 月
预计投资收益率	项目建成后将完善公司高精密 HDI 电路板产能瓶颈，匹配中长期业务增长规划，支撑公司高附加值产品产能落地，保障公司持续提升营收与盈利水平
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（二）项目市场定位及可行性分析

当前高端电子产业持续升级，PCB 行业高精密 HDI 电路板市场需求持续扩容，特别是随着 AI 服务器、消费电子、汽车电子等领域的快速发展，高阶 HDI 产品需求增长迅速。公司现有高阶 HDI 产能的瓶颈工序逐步趋于明显，通过技术改造与产能扩充，能够快速解决高精密 HDI 电路板产能瓶颈，提升产能规模，满足市场增长需求，巩固公司在高端 PCB 领域的市场地位。

公司深耕高精密印制电路板领域多年，在 HDI 电路板技术研发、生产工艺、品质管控等方面积累了丰富的丰富经验，核心技术团队稳定，高精密 HDI 电路板订单

储备充足，中长期客户拓展及产能投放规划清晰。本次技改扩产项目建成后可快速释放新增产能，匹配通讯电子、消费电子、高端显示、汽车电子等领域头部客户供货需求。

本项目符合国家先进制造业、电子信息产业提质升级相关产业政策，契合江西省电子信息产业高端化、智能化发展布局；项目依托公司现有厂区进行技术改造扩充产能，园区水电气、环保、物流等配套成熟，厂房基础设施完善，能够有效缩短建设周期、控制综合建设成本。

项目建设资金可通过自有资金、银行中长期贷款等多元渠道筹措，资金来源稳定可控，能够足额覆盖设备采购及技术改造投入。项目实施后可显著提升公司高精密 HDI 电路板产能规模与技术水平，进一步增强公司在高端 PCB 赛道的产能与交付优势，长期有利于提升公司整体营收规模与综合盈利能力。综合政策导向、市场需求、技术储备、建设条件、资金保障及长期经济效益等维度研判，本项目实施具备充分必要性与可行性。

三、 本次投资的目的及对公司的影响

（一）投资目的

本次投资系公司匹配高端 PCB 中长期发展规划的重要产能布局，通过对现有产线进行技术改造并购置先进生产设备，扩充高精密 HDI 电路板产能规模，抢抓市场发展机遇；提升公司高端产品供给能力，保障公司高附加值产品产能有序扩张，持续提升公司市场占有率与核心竞争力。

（二）对上市公司的影响

本次技术改造与产能扩充项目为公司 PCB 主业核心产能投资，符合公司长期发展战略。本项目对公司 2026 年度经营业绩不构成重大影响；项目建成投产后，将提升公司高精密 HDI 电路板产能规模与技术水平，支撑公司中长期业务扩张，对公司未来业务规模、经营效益产生持续积极作用。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对公司现有正常生产经营、日常财务状况及经营性现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、 风险提示

1、本项目尚需完成项目备案、环境影响评价、节能审查等法定审批程序，

审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2、项目建设周期内，设备采购价格等存在波动风险，可能造成项目投资成本超预期；同时设备交付周期、安装调试进度、技术人员配置等因素可能导致产能释放延期。下游电子行业技术迭代、市场需求变化也将影响新增产能的利用效率与经济效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，阶段性资金支出将抬升公司短期资产负债率，增加阶段性财务压力；若融资环境发生变化、后续产能规划落地不及预期，还可能面临融资成本上升、厂房利用率不足等风险。

公司将密切跟踪各项审批、设备采购及行业动态，强化项目进度管理、资金统筹及市场拓展规划，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日